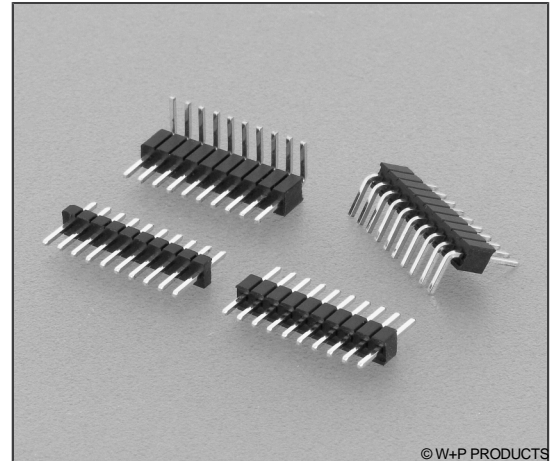


Stiftleisten RM 1,27mm, gerade/gewinkelt, 1-reihig – 1,0-2,5mm Isolierkörper Pin Headers, 1.27mm Pitch, Straight/Right-Angled, Single Row – 1.0/2.5mm Body

Technische Daten / Technical Data

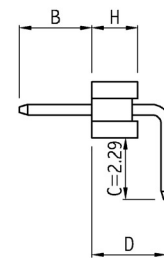
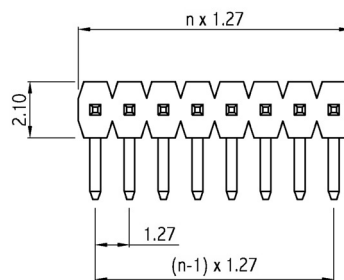
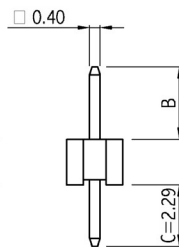
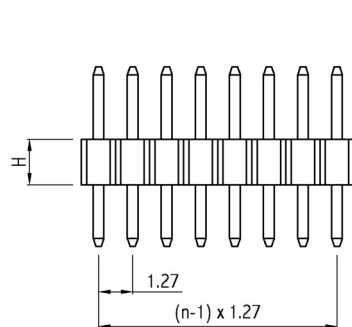
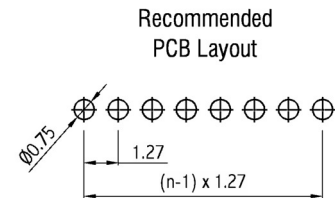
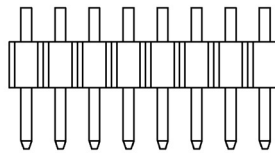
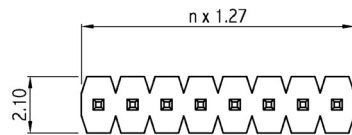
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,40mm, Kupferlegierung <i>0.40mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
605 etc.

Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



Series	Height*	Contacts*	Type*	Dimensions*	Plating*
707	2 1 H=1,00mm 2 H=1,50mm 3 H=1,70mm 4 H=2,50mm	50 02-50 Einreihig <i>Single row</i>	1 1 Gerade <i>Straight</i> 2 Gewinkelt <i>Right-angled</i>	10 10 B=2,70mm (D=1,50) 20 B=3,05mm (D=1,50) 30 B=1,91mm (D=2,20) 40 B=1,65mm (D=2,20) 50 B=1,91mm (D=2,80) 60 B=3,05mm (D=2,80) 99- Kundenspezifisch <i>Customer-specific</i>	60 00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i> 60 Sel. Au/Sn <i>Duplex plating</i>

Bmax = 15mm
Max. Stiftlänge / *max. pin length*: 25mm

Für die gewinkelte Variante ist das minimale Maß D durch die Isolierkörperhöhe H begrenzt.
For the angled type, the minimum of dimension D is limited by the height H of the insulator body.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* *This is an order example - please replace by your specifications.*

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

